

11.10.2007

Deutsche und koreanische Rektoren vereinbaren erleichterte Anerkennungsverfahren

Die Hochschulen in Südkorea und Deutschland wollen ihre Zusammenarbeit in Forschung und Lehre intensivieren und die gegenseitige Anerkennung akademischer Grade verbessern. Das vereinbarten die Hochschulrektoren und -präsidenten beider Länder in der vergangenen Woche in Seoul.

Die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Margret Wintermantel, unterzeichnete das Abkommen gemeinsam mit ihrem südkoreanischen Amtskollegen, Lee Jang-Moo „Mit etwa 5.000 südkoreanischen Studierenden an deutschen Hochschulen ist Deutschland das wichtigste Zielland in Europa. Das Rahmenabkommen über die Anerkennung von Studienabschlüssen wird die Studierendenmobilität nochmals erleichtern und die Kooperation zwischen den Universitäten und Fachhochschulen beider Länder vertiefen“, erläuterte HRK-Präsidentin Wintermantel.

Während ihres Aufenthaltes in Südkorea führte die deutsche Delegation unter Leitung der HRK-Präsidentin Gespräche mit südkoreanischen Hochschul- und Wissenschaftsvertretern. Im Rahmen eines gemeinsamen hochschulpolitischen Forums tauschten sich die Rektoren und Präsidenten über die Auswirkungen der zunehmenden Diversifizierung der Hochschulsysteme, die Förderung von Exzellenz und die Bedeutung der Geisteswissenschaften in beiden Ländern aus. Im Austausch mit Vertretern der deutschen Wirtschaft vor Ort wurde diskutiert, wie bestehende Hemmnisse in der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, insbesondere in Forschung und Technologietransfer, überwunden werden können.

Im Rahmen der Kampagne des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Deutschland und Korea: Partner in Forschung und Entwicklung“ hat die Hochschulrektorenkonferenz die Zusammenarbeit mit ihrer südkoreanischen Partnerorganisation, dem Korean Council for University Education, weiter ausgebaut. Sie fördert darüber hinaus drei deutsch-koreanische Forschungsprojekte in den Bereichen „Biotechnologie und ihre medizinische Anwendung“ (Universität Erlangen-Nürnberg), „Maschinelles Lernen“ (TU Berlin) und „Microelectronic Packaging und Systemintegration“ (ebenfalls TU Berlin).